

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-042

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/12/5
回购方案实施期限	2024 年 12 月 4 日~2025 年 12 月 3 日
预计回购金额	40,000万元~80,000万元
回购用途	☐ 减少注册资本 ☒ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	20,860,449股
累计已回购股数占总股本比例	6.34%
累计已回购金额	77,055.832137万元
实际回购价格区间	29.50元/股~40.41元/股

一、本次回购股份的基本情况

公司于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 42 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2.5 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 5 日和 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华懋科技关于 2024 年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-108）和《华懋科技关于 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-111）。

2024 年 12 月 19 日公司召开 2024 年第九次临时董事会，审议通过了《关于增

加 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份规模的议案》，同意公司增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的回购股份规模，由“不低于人民币 2.50 亿元（含），不超过人民币 5.00 亿元（含）”增加为“不低于人民币 4.00 亿元（含），不超过 8.00 亿元（含）”。除调整回购规模外，本次回购方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华懋科技关于增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份规模的公告》（公告编号：2024-115）和《华懋科技关于 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-116）。

二、本次回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 20,860,449 股，占公司目前总股本 329,060,195 股的比例为 6.34%，回购成交的最高价为 40.41 元/股，最低价为 29.50 元/股，成交总金额为人民币 770,558,321.37 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日